

- 4、客户定义的金属化孔，盘孔等大或盘比孔小的 PTH 需与顾客确认。
- 5、如客户设计线路分布不均，内层可以加流胶点，外层可以加分流铜块，内层：铜点直径 1.27MM,中心距离 1.8MM, 距离线路 2.0mm 以上。外层：直径 0.76MM,中心距离 1.27MM,距离线路 2.0mm 以上。
- 6、字符上焊盘或入孔，优先将字符移开。
- 7、沉金板须备注金厚大于 0.05UM，金手指板须备注金厚大于 0.76UM。
- 8、PCB 板四周板角外形如果设计为直角，加工时按直径 5.0MM 的圆角(即半径 R2.5MM)处理。板角外形非直角时按文件处理。单板有一边有工艺边时，只将工艺边导圆角，连工艺边单板不导圆角
- 9、设计重孔可以删除小孔，设计交叠孔，必须反馈确认。
- 10、过孔不允许破盘
- 11、所有 SMT 板都应该有基准标识，若 SMT 板上没有基准标识，必须及时通知客户确认，对于有工艺边的板(无论板内有没有基准点)，必须双面增加基准标识，基准点大小为 1.5MM，阻焊开窗 3.0MM，每面增加三个（只有一个工艺边时，加两个），具体位置为工艺边的中间离两端 4.0MM)
- 12、删除内层非功能性焊盘：允许加泪滴
- 13、非金属化孔设计有焊盘时，内层直接删除，外层焊盘直径比 NPTH 孔径大 0.5MM 以下时，直接删除此独立焊盘
若 NPTH 孔设计在大铜皮上，周围削铜皮，保证 0.25-0.40MM 的基材。
- 14、公司等标记没有特殊要求优先丝印在焊接面左上角(从焊接面看板时的左上角)，板内面积较小无法加下，可以加在附边上。
但是生产厂家标识必须印在每个单元内